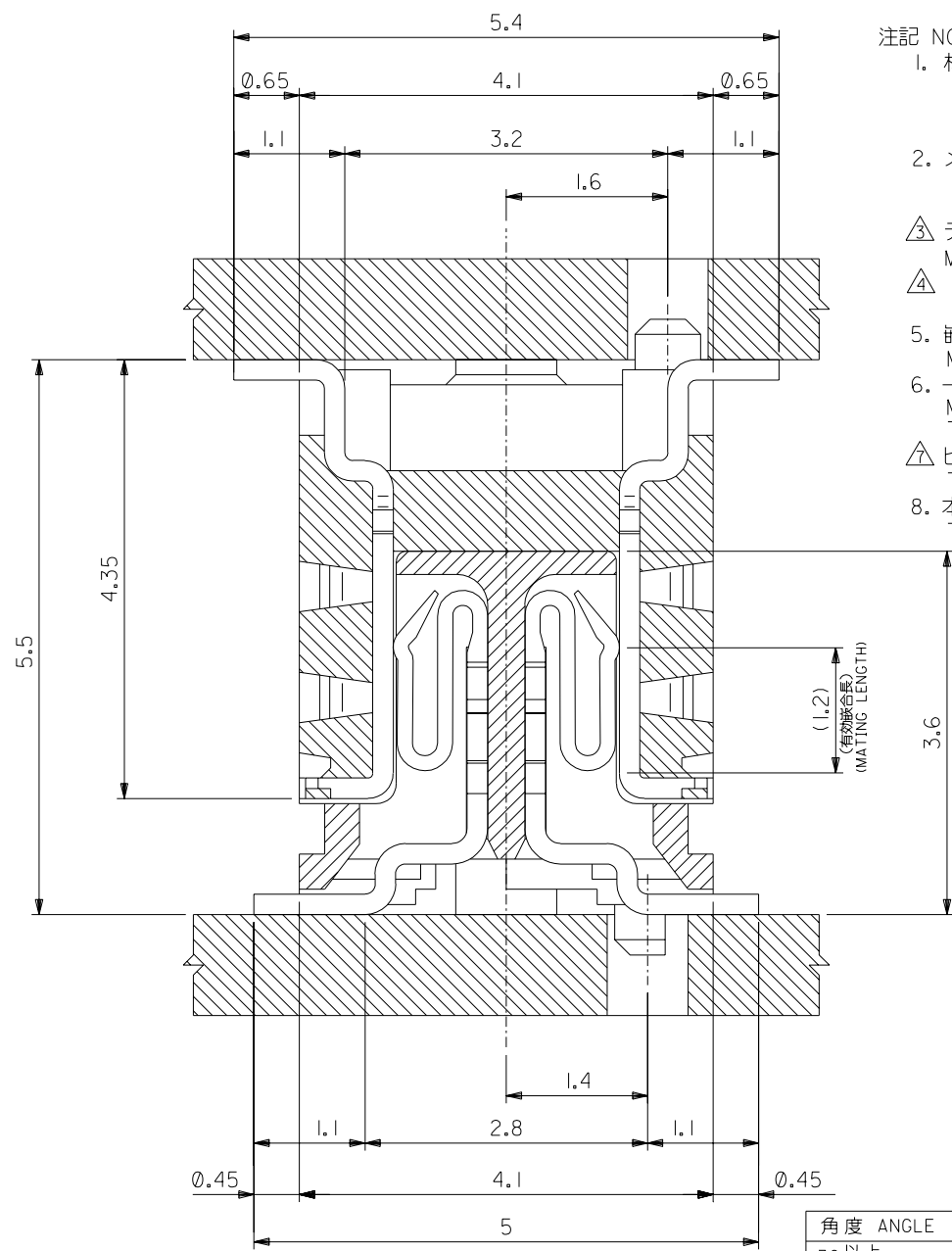


	22.1	23.2	21.3	20.65	19.5	25	55055-0871	80
	17.1	18.2	16.3	15.65	14.5	20	55055-0671	60
55055-***71	14.6	15.7	13.8	13.15	12	17.5	55055-0571	50
MODEL NO.	F	E	D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		//		TITLE 名称 0.5 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y WITH NAIL [H=5.5mm] -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		//		DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO	
角度 ANGLE ±3°				DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
30以上 OVER ±0.3				SD-55055-001 0	
10以上 OVER 30未下 UNDER ±0.25				APP'D BY '04/04/14 日付 DATE	
10未下 UNDER ±0.2				M.SASAO 尺度 SCALE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
		DR. CHK.		H.K. K.T. 04/04/14	
		新規作成 RELEASED (J2004-3788)		M.SASAO	



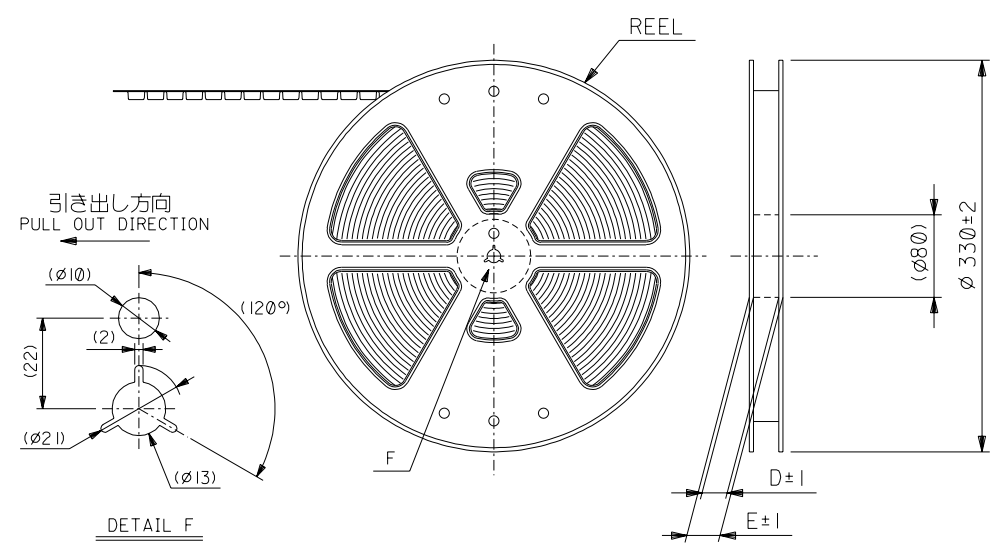
注記 NOTES:

1. 材質 MATERIAL
 ウエハー: LCP, (UL94V-0) WAFER: LCP, UL94V-0
 ピン: 銅合金 (t=0.2) PIN: COPPER ALLOY
 補強金具: 銅合金 (t=0.15) FITTING NAIL: COPPER ALLOY
2. メッキ仕様 PLATING
 ピン: 半光沢ニッケル下地金メッキ PIN: Au OVER HALF-BRIGHT Ni PLATING
 補強金具: ニッケル下地錫メッキ FITTING NAIL: TIN OVER NICKEL PLATING
- △ テールとネイルの相互のばらつきは0.1MAX.
 MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL AND NAIL OFFSET BETWEEN UPPER AND LOWER: 0.1 MAX.
- △ (極数/2) = 偶数の場合に適用。
 APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
5. 嵌合相手: 54154, 54230シリーズ。
 MATES WITH 54154, 54230 SERIES.
6. 一对の基板の嵌合に於いて、本製品を2個以上使用することは推奨致し兼ねます。
 MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.
- △ ピン先端は、側面壁 (V面) より出ない事。
 TIP OF PIN MUST NOT PROTRUDE OVER V.
8. 本製品は55055-***1の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE FO 55055-***1.

嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING(REFERENCE)

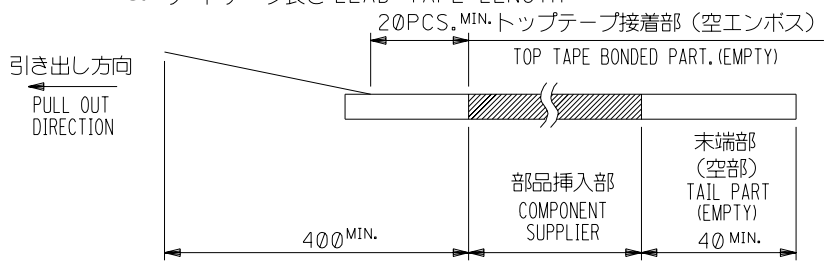
		MODEL NO.		55055-***71	
		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	
		仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES	
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—	
		被覆外径 INS. RANGE		—//—	
		DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO	
		RELEASD (J2004-3788) H.K. / K.T.		'04/04/14	
		APP'D BY '04/04/14 M.SASAO		尺度 SCALE —//—	
角度 ANGLE		+3°			
30以上 OVER		+0.3			
10以上 OVER 30未滿 UNDER		+0.25			
未滿 UNDER		+0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
		DR. CHK.		日付 DATE	

MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
FINISH		注記参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
WIRE RANGE		—//—		TITLE 名称 0.5 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y WITH NAIL [H=5.5mm] -LEAD FREE-	
INS. RANGE		—//—		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV 0	
				SD-55055-001	

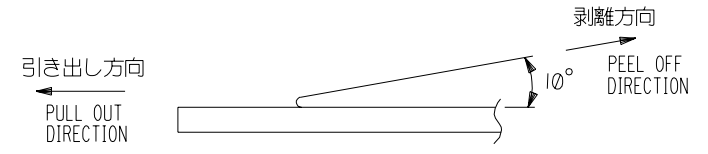


注記 NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-55055-001 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-55055-001.
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

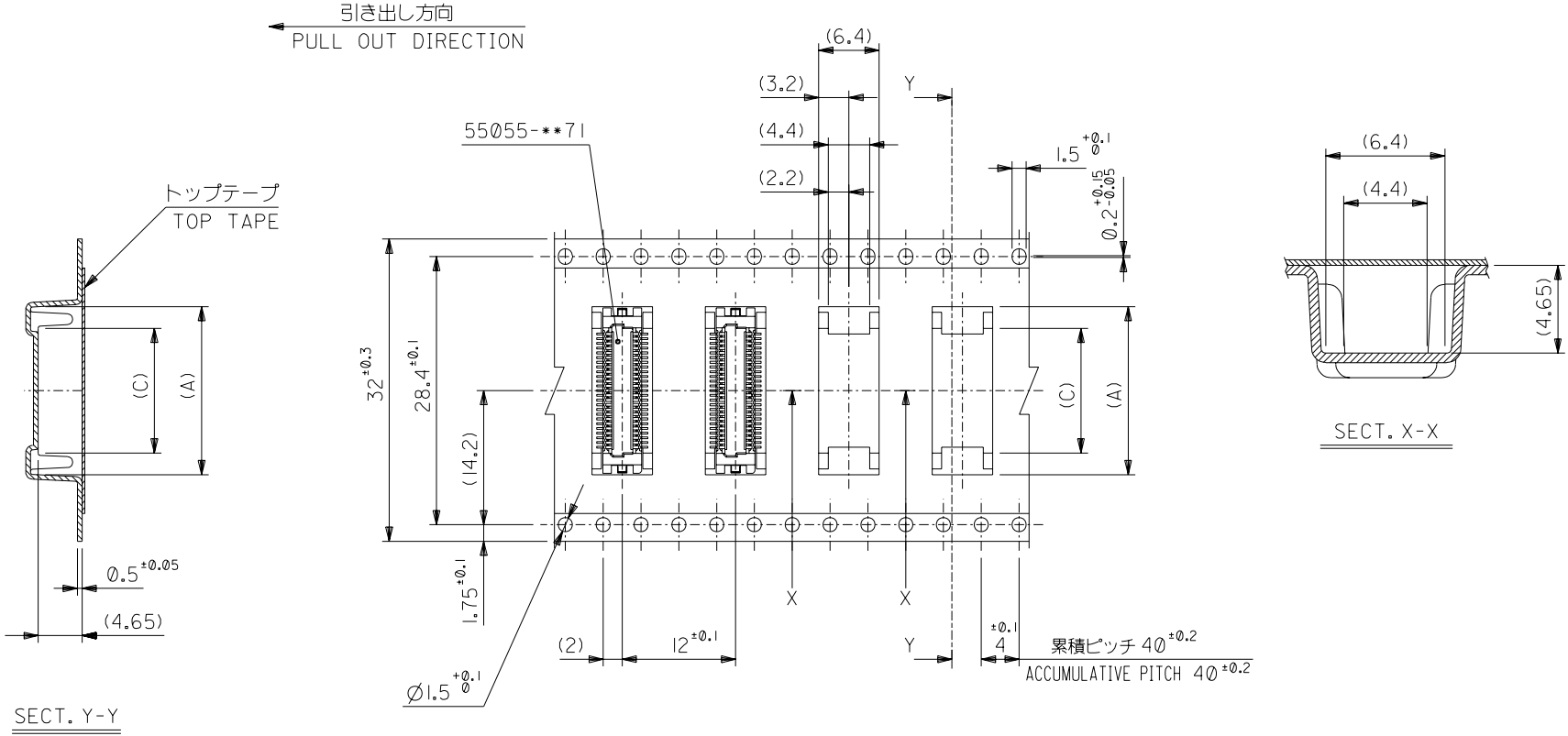


- トpptテープの剥離強度：0.1～1.3N(10～130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1～1.3N(10～130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



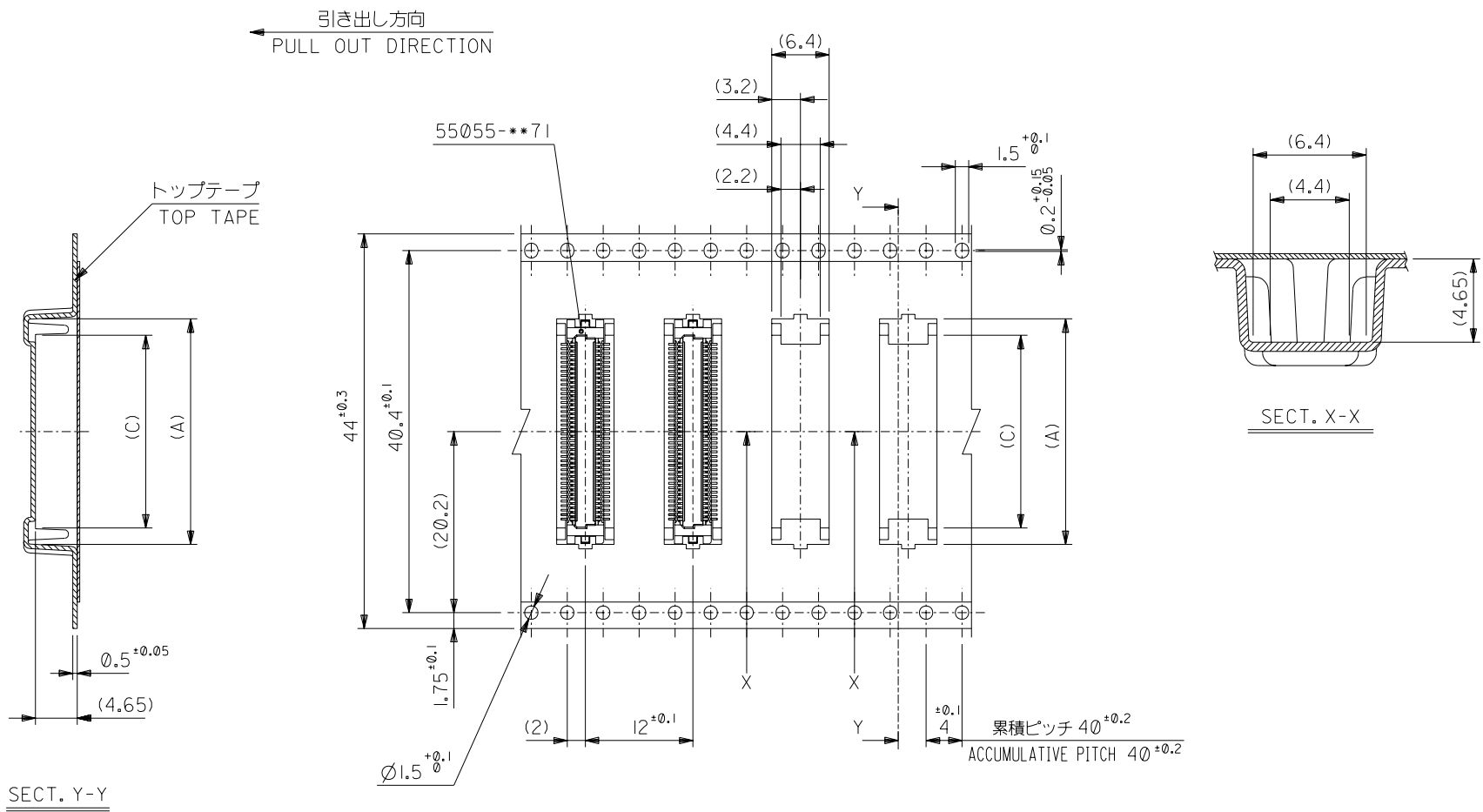
- 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トpptテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は 55055-***8 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55055-***8.

				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—//—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		TITLE 名称 0.5 BtB Conn WAFER Assy W/NAIL Hgt=5.5 Embstp Pkg	
				被覆外径 INS. RANGE		—//—		-LEAD FREE-	
角度 ANGLE		±3°		DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV	
30 以上 OVER		±0.5		APP'D BY '04/04/14 M.SASAO		尺度 SCALE		SD-55055-002 0	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		±0.25		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD			
未満 UNDER 10		±0.2		DR. CHK.		日付 DATE			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				0 新規作成 RELEASED (J2004-3788)					



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

		32	37.4	33.4	15.7	20.3	55055-0678	60	
55055-***78		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		E	D	(C)	(A)	55055-0578	50
MODEL NO.								MATERIAL NO.	極致 CKT.
		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
		仕上げ FINISH		—//—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		TITLE 名称 0.5 BtB Conn WAFER Assy			
		被覆外径 INS. RANGE		—//—		W/NAIL Hgt=5 Embstp Pkg			
		DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO		-LEAD FREE-			
		APP'D BY '04/04/14 M.SASAO		尺度 SCALE		DWG. NO. (SHEET 2 OF 3)		REV	0
角度 ANGLE		±3°							
30°以上 OVER		±0.5							
10°以上 OVER 30°未滿 UNDER		±0.25							
未滿 UNDER		±0.2							
一般公差 GENERAL TOLERANCES		0	新規作成 RELEASED (J2004-3788)		04/04/14				
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE					



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

55055-**78	44	49.4	45.4	21.5	25.15	55055-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.
	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
	仕上げ FINISH	—//—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
	適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—		TITLE 名称			
	被覆外径 INS. RANGE	—//—		0.5 BtB Conn WAFER Assy W/NAIL Hgt=5.5 Embstp Pkg -LEAD FREE-			
角度 ANGLE	±3°						
30以上 OVER	±0.5						
10以上 OVER	±0.25						
30未満 UNDER	±0.2						
10未満 UNDER	±0.2						
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	尺度 SCALE	DWG. NO.	REV
	0	新規作成 RELEASED (J2004-3788)	Y.K.	04/04/14	—//—	(SHEET 3 OF 3)	0
						SD-55055-002	